

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Nexchip 晶合集成

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

修訂公司章程

本公告由合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述本公司日期為2026年6月30日的招股章程，內容有關本公司股東於2023年8月31日批准的2023年限制性股票激勵計劃(「本激勵計劃」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與招股章程所界定者具有相同涵義。

於2026年8月24日，本公司公告本激勵計劃項下預留授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已達成，合共141,613股限制性股票可予歸屬。詳情請參閱本公司於2026年8月24日刊發的海外監管公告。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本公司已完成上述141,613股新增A股的登記工作(「本次歸屬」)。該等新增A股已於2026年9月18日上市流通。

緊隨本次歸屬完成後，本公司的註冊資本由人民幣2,234,645,597元增加至人民幣2,234,787,210元，而本公司的股份總數由2,234,645,597股增加至2,234,787,210股，其中A股普通股由2,007,591,697股增加至2,007,733,310股，H股普通股維持不變，仍為227,053,900股。為反映本公司註冊資本及股本結構的上述變動，本公司對本公司公司章程(「公司章程」)作出相應修訂。

公司章程的修訂詳情如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣223,464.5597萬元，總股數為223,464.5597萬股，均為普通股股份。	第六條 公司註冊資本為人民幣 223,478.7210 萬元，總股數為 223,478.7210 萬股，均為普通股股份。
第二十條 公司的股份均為普通股，每股面值人民幣壹元，其中A股普通股2,007,591,697股，H股普通股227,053,900股。……	第二十條 公司的股份均為普通股，每股面值人民幣壹元，其中A股普通股 2,007,733,310 股，H股普通股227,053,900股。……

根據本公司2023年第二次臨時股東大會通過的相關決議案，本公司股東大會已授權董事會辦理本激勵計劃相關事宜，包括根據本激勵計劃的實施結果修改公司章程、辦理本公司註冊資本變更登記及其他相關事宜。上述修訂自2026年9月29日經董事會審議通過後生效，無需經股東會審議。

經修訂的公司章程全文將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本公司將依據適用法律法規，向中華人民共和國相關政府及監管機關辦妥上述公司章程修訂事項之工商登記、備案及其他相關手續。公司章程的最終版本須以市場監督管理部門核准的內容為準。公司章程中文版本與英文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年9月29日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、藺智挺教授及陳鋌先生。